

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : MD-CD1MK3/MD-CD1BMK3/MD-70
PRODUCTS
変更番号 : EA6033
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : POWER SW基板固定用の子基板削除
TITLE
同期設変 : EA5891
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設変 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : POWER SW基板固定用の子基板削除
CONTENTS
POWER SWの変更 (EA5891) に合わせて、POWER SW基板の固定に使用している子基板を削除致します。

【対象機種】
MD-CD1MK3, MD-CD1BMK3, MD-70CD

【対象部品】
E90431600A PCB, POWER SUB MCD3 G → 削除
M0333460 SNAP RIVET, SR5-5.5 G → 削除

【実施に関して】
EA5891の変更に同期して実施をお願い致します。

【旧品処理に関して】
#E90431600A PCB, POWER SUB MCD3 G
→ 廃棄。(捨て基板と同じ処理。)
※互換性等は空欄となっておりますが、処理は以下となります。
C*352

#M0333460 SNAP RIVET, SR5-5.5 G
→ 不動在庫となりますが汎用性が高い部品の為、
旧品処理は“廃棄”では無く“転用”とし、暫く保留としてください。

译: 因POWER SWの変更, 所以POWER SW机板的锁付作业变更, 删除以下两个部品
E90431600A PCB, POWER SUB MCD3 G → 削除
M0333460 SNAP RIVET, SR5-5.5 G → 削除
以上两个部品の作业删除。具体请看技术连络书: DTS-4390

已实施

関連図面 : - - -

設変会議日 : 2019/10/08
DATE
担当 : 1720 fujino yoshiki
PERSON IN CHARGE
依頼元 : 生産技術課
REQUESTING SECTION
設変会議 : 要 To be held
E. C. MTG.
P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書No : X3109
ENG. INFO. NO.
実施 : To be enforced
ENFORCEMENT
変更理由 (主) : ERROR OTHERS
REASON (MAIN)
変更理由 (従) :
REASON (SUB)
安全規格 : NOT required
SAFETY STD
進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT
機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL
客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE
作業標準訂正 : Required
CHG. IN MFTR. MANUAL
技術情報発行 : To be issued
ENGINEERING INFO.
コスト変動 : No change
COST
単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

RELATED DRAWINGS

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : MD-CD1MK3/MD-CD1BMK3/MD-70CD
PRODUCTS

変更番号 : EA6033
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2019/10/08
DATE
タイトル : POWER SW基板固定用の子基板削除
TITLE

親品目 : E90426100A GATHER PCB,PWRSW MCD3 G MATERIAL (1)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	明細番号						
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1	#2	#3	#4
1- 1	E90431600A	PCB, POWER SUB MCD3 G		4. 000	0020									
親品目 : Y00536700A CHASSIS SECT, MCD3 (G) MATERIAL (2)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	明細番号						
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1	#2	#3	#4
2- 1	M0333460	SNAP RIVET, SR5-5. 5 G		1. 000	0065 C* 3 5 2									
親品目 : Y00536754A CHASSIS SECT, CHI MCD3 (G) MATERIAL (3)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	明細番号						
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1	#2	#3	#4
3- 1	M0333460	SNAP RIVET, SR5-5. 5 G		1. 000	0065 C* 3 5 2									
親品目 : Y00537700A CHASSIS SECT, MCB3 (G) MATERIAL (4)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	明細番号						
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1	#2	#3	#4
4- 1	M0333460	SNAP RIVET, SR5-5. 5 G		1. 000	0065 C* 3 5 2									
親品目 : Y00718901A CHASSIS SECT, MD70CD DM (G) MATERIAL (5)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	明細番号						
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1	#2	#3	#4
5- 1	M0333460	SNAP RIVET, SR5-5. 5 G		1. 000	0070 C* 3 5 2									

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : MD-CD1MK3/MD-CD1BMK3/MD-70CD
PRODUCTS

変更番号 : EA6033
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 : 2019/10/08
DATE
タイトル : POWER SW基板固定用の子基板削除
TITLE

#1	CMP : 互換性 COMPATIBILITY	#2	2ND : セカンド区分 2ND VENDER	#3	INS : 手配指示 INSTRUCTION	#4	PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1ST	A 有 COMPATIBLE	1	有り EXIST	1	既出荷品 SHIPPED PRODUCTS	1	転用 CONVERSION
BYTE	B →	2	優先 PREFERENTIAL	2	仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)	2	廃棄 DISPOSAL
	C ←	3	無し NOT EXIST	3	在庫部品 STOCK	3	追加工 REPROCESSING
	D 無 NOT COMPATIBLE			4	外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER	4	消化 CONSUMPTION
				5	新規発注 NEW ORDER	5	無し NOT NECESSARY
				9	未定 NOT DECIDED	9	未定 NOT DECIDED
2ND	1-9 SIMULTANEOUS CHANGE						
BYTE	* NO SIMULTANEOUS CHANGE						